INDIA × JAPAN

インド高度人材活用による
日印連携シリーズ第３回

日印新時代

～2040年を見据えた
「成長17分野」とインド市場参入戦略

01 / 02





01　モディ首相 / マイクロン・メモリーSanand工場を訪問





02　ナビムンバイ・Yotta NM1／世界第2位、アジア最大のデータセンター



03　AIロボット



04　ノビタ・インドへ留学

JIVAA Fintech Solutions Pvt. Ltd　2026.11.18



登壇者紹介

にしばし ときお

西橋 時男

JIVAA Fintech Solutions Pvt Ltd.
上級執行役員兼日本戦略執行顧問 東京在住

E: tokionishibashi58@gmail.com

総合商社駐在員として5年、JETROの投資アドバイザーとして5年、2回にわたりインドに駐在、近年では2020年にインドに出張し発展するインドに対する知見を深めた。その後もインド大手会計事務所で長年にわたり日本企業のインド進出を支援してきた弊社CEOのHimanshu氏と日印ビジネス交流の深化についてムンバイ・東京間で情報交換を続けている。

製造業では、インドが「強化」、日本が「復活」を掲げ、産業基盤の再構築を進めています。日本企業はこれまでインド市場において、自動車産業を中心に大きな存在感を示してきました。

本年は、高市首相のインド訪問を契機に、AI・半導体分野における日印連携が政府・民間の双方で急速に進展しています。半導体サプライチェーン強化やAI人材活用など、新たな協力の動きも活発化しています。

日本にとってインドは、約14倍の人口を持ち、高成長を続ける重要市場です。欧米企業も注力するなか、北米に次ぐ戦略市場としてその重要性が高まっています。

私見ですが、今後の日印連携をさらに加速させる鍵は、世界有数のAI・デジタル競争力を持つインドの
高度外国人材の両国における活躍にあると考えています。

本セミナーでは、戦略17分野を中心に、2040年を見据えた日印連携の可能性とビジネス機会についてご紹介いたします。」

インド高度人材活用による日印連携シリーズ　第3回

日印新時代　～2040年を見据えた「成長17分野」とインド市場参入戦略

2040

～AIロボット、データセンター受配電・液冷、再エネEPCから消費財・外食・コンテンツまで～

2040年度までに、資金と機会はどこに集中するのか。

官民投資370兆円超 × インド2040

西橋 時男　|　**JIVAA Fintech Solutions Pvt. Ltd.**

2026年11月　|　全29ページ（表紙3＋本文13＋参考資料13）

KEY METRIC・累積事業規模（推計）

20.2兆円

2026～2040年度の日系企業 事業規模

官民投資370兆円超 × インド2040

高市内閣「成長17分野」×「インド2040」解説

〜AIロボット、データセンター受配電・液冷、再エネEPCから消費財・外食・コンテンツまで〜

2040年度までにどこに資金と機会が集中するのか？

日本政府が促す成長17分野の最新動向と、日本企業がインドで狙うべき「部品・機器輸出」「現地生産・工場建設」「戦略的出資・成長支援」の最前線。

2040

KEY METRIC · 累積事業規模（推計）

20.2兆円

2026〜2040年度の日系企業 事業規模

官民投資370兆円超の「成長17分野」と、2040年のインド市場。二つを重ねたときに生まれる金額。

4つの結論 — 資金と機会はどこに集中するか

01

日系企業の2040年度事業規模

2.5〜3.0 兆円／年（推計）

年間2.5〜3.0兆円規模へ到達する事業機会

02

2026〜2040年度の累積事業規模

20.2 兆円

うち現地直接投資（FDI）約9.7兆円

03

在インド拠点の停滞

1,434社 / 5,205拠点

2018年頃から横ばい — 拡大余地あり

04

10年で10兆円の民間投資目標

旧目標5兆円を3年で達成

延伸可能 — 次の10兆円フェーズへ

推計の前提：2026〜2040年度の15年間・1ドル=155円・CAGR外挿・日本企業シェア10〜35%と仮定。出典：JETRO・経済産業省資料ほか。

インドのマクロ — 15年で見ても成長が続く

GDP成長率

+7.4%

2025年度 / インド統計局の予測

出典: Reuters 2026-01-08

中間所得層

約8億人

2030年 / 世界最大規模の中間市場へ

出典: くにうみ会計事務所／WEF

50万人超の消費者都市

149都市

2040年 / 米中欧を上回る規模

米国53都市・欧州112都市を上回る

総括

人口ボーナス・中間層拡大・都市化が同時進行する15年間。

国内市場の伸びが先行する日本企業にとって、「次の20年」の最大フロンティア。

政府目標の「前倒し達成」が次の規模を決める

NEW 10-YEAR PRIVATE INVESTMENT TARGET

10年間の新たな民間投資目標

10 兆円

2036年までの目標

旧目標（2022年）5兆円・5年 → 3年で達成（前倒し）

大型プロジェクトの進捗と円借款

2025年の協力文書

129 件

半導体・バイオガス等が対象

円借款 — 高速鉄道

3,000 億円

ムンバイ〜アーメダバード第四期／総事業費の最大81%

円借款 — 貨物専用鉄道（DFC）

7,800 億円

デリー〜ムンバイ間／三井物産らも参画

政策の枠が開いているうちに入る。円借款・PLI・ECMS・再エネ入札は、いずれも「先着」の性格が強い制度です。

なぜ前倒しが続くのか

目標を前倒しで達成すると、次の目標がより大きな金額で設定される。この繰り返しが、日本企業にとっての案件量そのものを増やしています。

分野別の2040年度市場規模と日本企業の獲得余地

分野	2040年度インド市場規模（年）	日本企業年間獲得（推計）	2026〜40 累積	うちFDI累積
① フィジカルAI・AIロボット	約1.5〜2.0兆円	約0.5兆円	約2.8兆円	約0.8兆円
② AIデータセンター向け 変電・受配電	約1.0〜1.3兆円	0.15〜0.2兆円	約2.0兆円	約0.8兆円
③ 液冷・熱交換	約0.4〜0.5兆円	0.05〜0.08兆円	約1.4兆円	約0.6兆円
④ 海水淡水化・再エネEPC・系統	約4〜5兆円	約0.5〜0.8兆円	約5.0兆円	約1.5兆円
⑤ 電子部品・半導体	約8〜10兆円	1.0〜1.5兆円	約5.0兆円	約2.0兆円
⑥ 消費者向け（食品／アパレル／都市開発）	約60兆円（日系が狙える領域は約10兆円）	約0.3〜0.5兆円	約4.0兆円	約4.0兆円
合計	—	2.5〜3.0兆円／年	20.2兆円	9.7兆円

推計の前提：2026〜2040年度を対象とし、為替レートは1ドル＝155円で換算。市場規模は公表されている市場予測をベースに将来の成長を見込み算出。日本企業シェアは10〜35%の範囲で想定。

読み方：⑤電子部品・半導体の「累積5.0兆円」は、市場が8〜10兆円でも日系シェアが10〜15%に留まるため。⑥消費者向けは累積の大半がFDIになる。

3つの参入形態を組み合わせる

分野ごとに有効な形態は異なる — 自社の強みに応じて使い分ける

I
輸出で対応

短期間に着手でき、需要変動に柔軟に対応

適する分野

電子部品（コンデンサ・コネクタ）／変圧器・電源機器／一部半導体装置

II
現地生産 FDI（海外直接投資）

関税回避・地場PLIを使い中長期コスト競争力を確保

適する分野

空調・熱交換・変圧器・配電機器／OSAT（半導体後工程受託企業）・後工程半導体／産業ロボット・センサー

III
商社主導の消費者向け投資

インド側パートナーと組み、出資・合弁で需要を取りに行く

適する分野

コールドチェーン・食品物流／消費財・アパレル／都市開発・大型不動産

注記：本資料の推計は輸出＋FDIの合算 ≡「日本企業の事業規模」。3形態は排他ではなく、同一企業が分野ごとに使い分ける前提。

15年の累積 20.2兆円、うちFDI 約9.7兆円

2026〜2040年度の累積事業規模

20.2 兆円

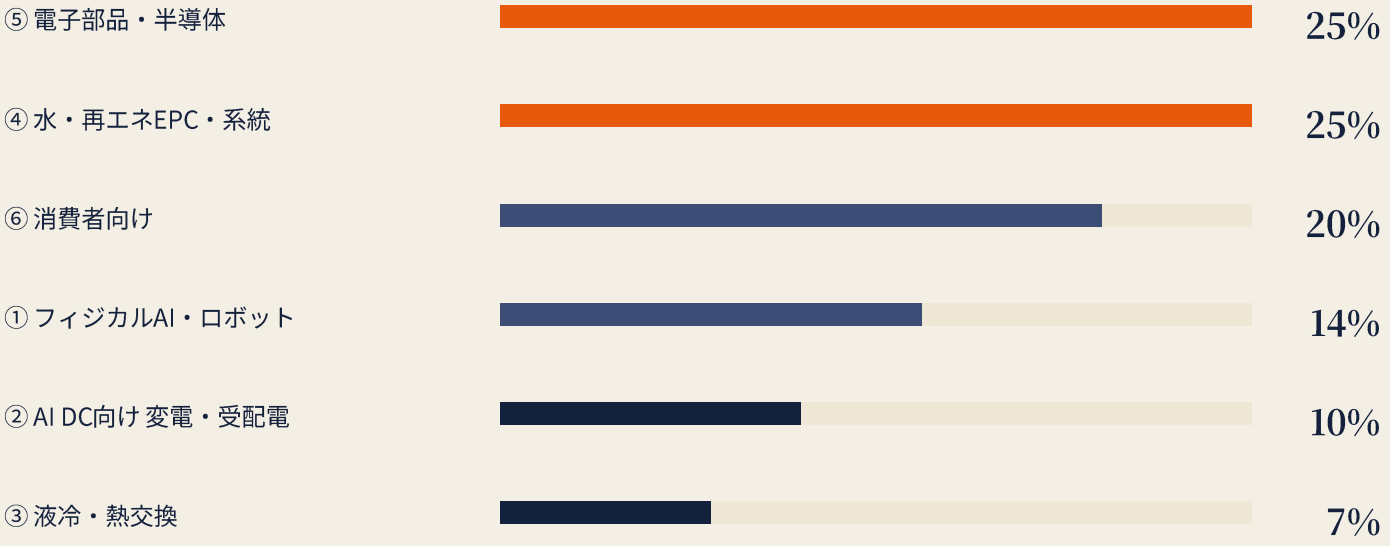
推計

うち現地投資（FDI）

9.7 兆円

年2.5〜3.0兆円の事業機会に
2040年度に到達

分野別の構成（推計）



合計 101%（端数調整前・推計ベース）

上位3分野で7割。経営資源を寄せる順序が、そのまま成果の差になります。

推計の前提：2026〜2040年度の15年累積・1ドル=155円・CAGR外挿・日本企業シェア10〜35%と仮定。政府目標「10年で10兆円」の延長上に整合。

ファナック・安川・川崎重工らが産業用ロボット4強の一角として参画

2026〜40年度 累積事業規模（推計）

約2.8兆円

内訳：輸出 1.8兆＋
現地エンジニアリング 1.0兆

うちFDI

約0.8兆円

輸出が半分以上。短期で数字が出る分野です。

フィジカルAI 社会実装の協業

富士通 × ファナック・安川電機・川崎重工

NVIDIA技術を取り込んだ事業検討（2026年7月）／ファナックはNVIDIA、安川電機はソフトバンクと協業

日本企業（参画例）

ファナック／安川電機／川崎重工／不二越／デンソー／三菱電機／オムロン／パナソニック コネクト／ソフトバンクロボティクス

インド企業（候補例）

GreyOrange／Addverb／Wipro PARI／Tata Elxsi／LTIMindtree／Infosys／Godrej & Boyce／Mahindra

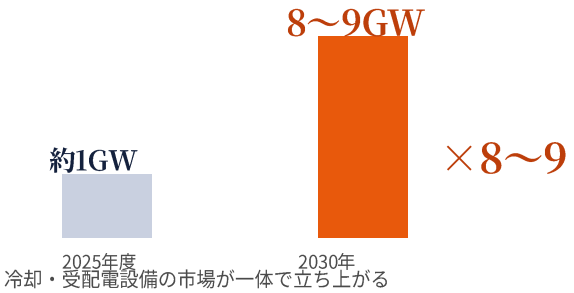
補足

ファナックは2026年3月、バンガロール本社敷地内に保守部品倉庫等の新サービス棟を建設。

出典：ファナック 2026-05、富士通 2026-07、Diamond Online、ロボット革命インダストリアルシェア

IT負荷8〜9倍へ — ハイパースケーラーと地場巨額投資が同時進行

IT負荷の推移（推計・GW）



冷却・受配電設備の市場が一体で立ち上がる

RELIANCE INDUSTRIES
1,098億ドル
7年でAI・DCインフラ／ジャムナガル港湾に120MW超

ADANI GROUP
1,000億ドル
2035年までにAI DC 2GW→5GW／Googleと最大級キャンパス

HYPERSCALERS・表明済コミット

Google	150億
Microsoft	175億
AWS	127億

3社で合計 約450億ドル

日本企業の入り方 — 3経路

ROUTE 01
DC容量の直接保有・運用
NTT：3年で15億ドル追加投資

ROUTE 02
不動産プラットフォーム経由
三井不動産：CapitaLandと3都市200MW

ROUTE 03
受変電・冷却機器・電源システム
東芝・三菱電機・ダイキン・日立

3つ目の参入経路である「機器納入」は、日本企業が最も強みを発揮しやすい分野です。特に液冷、受変電設備、UPS（無停電電源装置）は、日本で実績のある技術をインド市場にも展開できる有望領域です。

出典：Reuters 2026-02、Ledge.ai、EdgeConneX、G-japan、Introl

500GW目標の達成と送電網900GW計画が同時進行

2030年 再エネ目標

500 GW

非化石電源・年約50GWの新規増設が必要

進捗（2026年2月時点）

275 GW

目標の55%／残り225GWが未達

2035年 系統接続計画

900 GW

National Resource Adequacy Plan

商社主導の動き — 太陽光・分散電源・炭素クレジット

住友商事

1,000 億円

太陽光・陸上風力の整備と工場直供

三井物産 × 中部電力

OMC パワー

分散型電源・グリッド運営に出資参画

丸紅

10,000 ha植林

炭素クレジット事業／商船三井と2028年以降の取扱目指す

市場機会は、「発電」「電力インフラ」「脱炭素」の3分野に広がっています。特にEPC（一括請負）や変圧器・開閉器・ケーブルなどの設備機器は、商社が主導する大型案件に参画することで、比較的早く事業機会を獲得できます。

出典：JETRO 2023-10、Mitsui Report 2024、Enerdata、SPAP、住友商事リリース、丸紅リリース

ECMS 46件・第3弾22件で7,535億円を承認

インド政府　電子部品製造優遇スキーム（ECMS）

46 件
累計承認

7,535 億円
第3弾22件の投資額

33,791 人
直接雇用

対象分野（第3弾）

PCB	コンデンサ	コネクタ	筐体（きょうたい）Housing
LiBセル	カメラモジュール	ディスプレーモジュール	光トランシーバ

企業動向 — 承認と体制再編が同時進行

TDK
コンデンサ製造計画がECMSで承認。2026年4月、アジア・パシフィック本社をインド＋シンガポールの2拠点体制に再編（生産能力を倍増）。

村田製作所
インドで営業拠点を拡充、需要急増に対応。

業界の主要日本企業
京セラ ／ 太陽誘電 ／ アルプスアルパイン ／ ローム ／ ルネサス ／ ソニーセミコンダクタ ／ ヒロセ電機 ／ JAE

出典：JETRO 2026-01、TDK 2026-03、日本経済新聞 2025-11

数値の読み解き方 — 不確実性を内訳で示す

リスク要因
DOWNSIDE FACTORS

A マクロ・為替
ルピー安・州ごとの税制差・人材獲得競争

B 電力・水制約
酷暑による電力・水の逼迫、DC冷却需要に直結

C 競合
韓国・中国・欧州勢＋地場台頭（サムスン プネ工場等）

D 再エネ目標・規制
500GW目標の達成ペースに専門家の警告

推計の前提
5つの仮定を確認してください

01 **対象期間は2026〜2040年度の15年間**

02 **年度平均レート 1ドル=155円で換算**

03 **市場規模は、公表されている市場予測の年平均成長率（CAGR：8〜25%）に基づいて推計**
2040年以降は逓減（年5〜13%）を仮定

04 **日本企業の獲得シェアは分野別に10〜35%と仮定**

05 **シェア・CAGR・為替は実際の投資で変動**
投資判断に応じて逐次更新すること

出典：本資料「0. マクロ・政策」「7. リスク要因」セクション、研究ノート全体

13 · RECOMMENDATIONS

日本企業が取るべき 3つの一手

01

POLICY-LINKED

政策連動の大型案件に早期参画する

円借款・ECMS・再エネ入札などの政策枠組みに早い段階で入る。

先例

東芝の変電器2倍化／三井物産のKaynes出資／住友の1,000億円再エネ

02

PARTNER & INVEST

地場パートナーと出資・合弁を組む

Reliance・Tata・Adani・Wipro等の地場リーダーへの出資比率を高め、リスクを下げつつ販路を獲得する。

先例

Reliance／Tata／Adani／Wipro／LTIMindtree／Infosys

03

AI × HARDWARE

AI・デジタル人材とハードウェア知見を結合

自前主義を離れ、現地のSI・ソフト企業のプールと組む。

雛形

ファナック・富士通・NVIDIA協業枠組み／ダイキン×NTTデータの統制御

注記：本資料の数値・出典はスライド06・07・13参照。最終更新2026年10月。

2040年までの15年間は、需要拡大と政策支援が同時に追い風となる絶好の事業機会の期間です。

本資料に関する事前質問への回答

Q1　「20.2兆円」の算定根拠は？

これまでの市場の伸び方をもとに2040年の市場全体を予測し、そこに日本ののシェア（10〜35%）を掛け合わせ、インドへの輸出と現地ビジネスの利益を足してトータルの金額を計算した。その際のお金のレートは1ドル155円で計算している。

Q2　なぜ日系シェア10〜35%なのか

分野別の実績と競合状況から設定。電子部品・半導体は高め、消費者向けは低めに置いた。

Q3　円安・円高で数字は変わるか

155円が前提。円建ての事業規模は動くが現地コストも連動するため、実質影響は限定的。

Q4　中国の代替拠点として見るべきか

主眼は国内需要。輸出拠点ではなく市場として見る。第3国向け輸出は補完的。

Q5　拠点横ばいで20.2兆円は矛盾しないか

既存拠点の規模拡大と新分野への参入で達成可能。横ばい自体が伸びしろの裏返し。

Q6　最初に着手すべき分野は

短期は電子部品の輸出とAI DC向けの受変電・冷却。中長期は現地生産FDI。

Q7　ECMSの採算と要件は

対象8分野・累計46件。PLI相当の優遇で初期投資を圧縮。個別要件はJETRO資料を参照。

Q8　AI DCの電力・水制約は

酷暑による電力・水の逼迫が最大の制約。液冷と再エネ調達の同時設計が必須。

Q9　人材はどう確保するか

2040年にAI・ロボット利活用で約339万人、現場人材で約260万人が不足。HCLTech等と組む。

Q10　州選定・税制の実務的な注意点は

州ごとに税制・電力料金・優遇が異なる。進出州の選定が収益を左右する。

AI DC（AIデータセンター）を4段階で整理 — 稼働・建設・承認・構想

I 稼働中

1.7 GW

Yotta・Microsoft・AWS・IndiaAI（GPU3.8万基超）が実需を担保

II 建設中

1.3 GW

Google ビジャーガ1GW・Reliance ジャムナガル120MW・AWS着工

III 政府承認

4.7 GW

テランガナ4.7GW／IndiaAI予算1,037億ルピー／AP州480エーカー

IV 計画発表

3.2 GW

OpenAI 1GW超・Adani 5GW（2035年）・Yotta 8万基・PDG 1GW

投資表明の内訳（AI・DC関連）— 5社合計2,550億ドル（うちハイパースケーラー3社452億ドル）

企業	金額	内容
Reliance Industries	1,098 億ドル	7年でAI・DCインフラ計画（Reuters 2026-02-19）
Adani Group	1,000 億ドル	2035年までにAI対応DC（Adani公式 2026-02）
Microsoft	175 億ドル	2025-12-09発表・2029年までの投資（Microsoft）
Google	150 億ドル	2026-04-28発表・ビジャーガAIハブ（Google Cloud）
AWS	127 億ドル	2023-05発表・2030年までの投資計画（AWS）

計算根拠：1,098＋1,000＋175＋150＋127＝2,550億ドル。うち175＋150＋127＝452億ドルがハイパースケーラー3社。

AI　データセンター

すでに稼働 — 地場GPUクラウドとクラウド4地域が実需を担保

Yotta（ナビムンバイ）

8,192 基 H100が稼働

ナビムンバイNM1でGPUクラウド「Shakti Cloud」を運用。H100 8,192基＋L40S 1,024基で国内最大級。グレーターノイダNM2も稼働。

Microsoft

4 地域目が稼働

ハイデラバード「India South Central」が2026年8月に稼働した4地域目。AI対応設計で、アジア・グローバルサウスの戦略ハブに指定（累計コミット205億ドル）。

AWS

2 地域が稼働

ムンバイ（2016年）とハイデラバード（2022年）の2クラウド地域が稼働。テランガナ州へ70億ドルの追加投資を進行中。

IndiaAI 共通計算基盤

3.8 万基超のGPUが稼働

政府AI計算ポータル経由で3.8万基超のGPUが稼働（2026年3月時点）。研究・スタートアップ向けに割安で計算力を提供。

そのほか稼働中 — CtrlS 19拠点・370MW超 ／ STT GDC 300MW超 ／ AdaniConneX チェンナイ第1期17MW（33MWへ） ／ NTT・Equinix・Nxtra

出典：Data Centre Magazine 2026、Microsoft 2026-08、AWS、PIB 2026-03、Blackridge Research、各社公開情報

19 / 29

AI データセンター

建設中 — Google・Reliance・AWSが同時着工

Google × AdaniConneX

150 億ドル（2026-30年）

ビジャーガパトナムに1GW規模・3棟のAIハブ。2026年4月28日に着工、2028年7月の運転開始を目標。Nxtra（エアテル）が建設を支援。Googleとして国外最大のAI投資。

Reliance ジャムナガル

120 MW を2026年末に

「Reliance Intelligence」が建設を主導し、最初の120MWを2026年末までに稼働へ。Metaとの契約（2026年6月）で168MW施設をMetaへリース、増設オプション付き。

AWS テランガナ州

6,000 億ルピー規模で着工

バラト・フューチャーシティで着工済み。州との70億ドル枠組み協定に基づき、ムンバイ・ハイデラバード両地域の容量を増強。

国内オペレーター各社

1.3 GW が建設中（合計）

STT GDCパラバ50MW（2026年3月着工）／Sify ナビムンバイ・チェンナイ103MW（IFC出資）／AdaniConneX ノイダ50MWなどが進行中。

稼働1.7GW＋建設中1.3GW — 液冷・受変電・再エネ調達が同時化し、機器・工事とも逼迫が見込まれる（Express Computer 2026）

出典：Google Cloud 2026-04、Meta 2026-06、Business Standard 2026-06、DCD、Blackridge 2026-03、IFC 2026-06

政府承認 — 州政策と連邦政策がDC建設を後押し

IndiaAIミッション（連邦）

1,037 億ルピー（閣議承認）

2024年3月に閣議承認（予算1,037.2億ルピー）。GPU 3.8万基超を承認・登録し、利用案件190件を承認。2026年10月に追加1万基の入札を公告。

アーンドラ・プラデーシュ州

480 エーカーの土地を承認

Google×Adaniのビジャーガ計画向けに480エーカーの土地譲渡を承認。州投資促進委員会が投資案を審査・認可。

テランガナ州

4.7 GW の設置をコミット承認

稼働200MWに次ぐ4.7GWの設置コミットを承認。チャンダンヴェッリーとバラト・フューチャーシティに専用クラスタを整備。

ウッタル・プラデーシュ州

2 兆ルピーの投資目標

データセンター政策2026を2026年7月に承認。GPU・AI対応を重点に、投資2兆ルピー・2030年までに10GWの誘致を目指す。

連邦も全国DC政策を準備中（2026年10月）— 電力価格と使用量への懸念を受け、制度の一本化を図る

出典：PIB 2026-03、MeitY／C-DAC 2026-10、CNBC-TV18、Invest Telangana、UP州政府 2026-07、Reuters 2026-10

AI データセンター

計画発表 — OpenAI 1GWと地場5GW構想が次の波

OpenAI Stargate India

1 GW超のDCを構想

1GW超のデータセンターを計画し、地場事業者と交渉中（2025年9月報道）。2026年2月、TCSのデータセンター事業の初の顧客に。

Adani Group

5 GW へ拡大構想（2035年）

AIデータセンターを2GW→5GWへ拡大する構想。Googleとビジャーガに最大級キャンパス。総投資1,000億ドル計画の一環。

Yotta

80,000 基超の次世代GPUを計画

FY27-28までにB200・B300など次世代GPU 8万基超へ拡張する計画。資金調達のため約800億ルピーのIPOを検討（報道ベース）。

PDG／CtrlS

25 億ドル（PDG・計1GW）

PDGは2026年3月にムンバイ・ハイデラバードへ210MW追加と25億ドルを表明（インド計1GW）。CtrlSは4.4GWの増設余地を確保。

承認・着工前の段階 — 電力・水・土地の確保が前提で、前倒しも縮小もあり得る。四半期ごとの動向確認を推奨

出典：Bloomberg 2025-09、Reuters 2026-02、Data Centre Magazine、DCD、Capacity Media ほか

22 / 29

半導体

総額178億ドル — 半導体15プロジェクト全貌（Capex降順）

No	Company/Project	Location	Type	Year	Capex (USD, M)	Capacity	Capacity Unit	Status
8	Tata + PSMC	Dholera, Gujarat	300mm Fab	2024–	9,577.7	50,000	WSPM	建設中
9	TSAT (Tata)	Morigaon, Assam	ATMP	2024–	2,841.7	48	M units/day	建設中
2	Micron Technology	Sanand, Gujarat	ATMP (DRAM/NAND)	2023–2026	2,369.8	Tens of millions	units/yr (2026)	稼働中
5	CG Semi	Sanand, Gujarat	OSAT	2024–	799.9	15	M units/day	稼働中
1	SCL	Mohali, Punjab	Front-end 180nm	1964–	473.6	180nm CMOS, 8" fab	process node	稼働中
4	RRP Electronics	Mahape, Mumbai	OSAT	2024–	378.9	QFN packages	package type	稼働中
6	Kaynes Semicon	Sanand, Gujarat	OSAT	2024–2026	348.1	6	M units/day	稼働中
14	Crystal Matrix	Dholera, Gujarat	GaN Mini/Micro-LED	2026–	322.9	72,000	sqm/yr	承認済 2026/5
10	SiCSem	Info Valley, Odisha	SiC Fab + ATMP	2025–	217.4	60k wafers + 96M units	mixed	建設中
11	3D Glass Solutions	Info Valley, Odisha	Advanced Packaging	2025–	204.5	69,600 panels + 50M units	mixed	建設中
15	Suchi Semicon (SSPL)	Palsana, Surat	OSAT (Discrete)	2026–	91.4	1,033.2	M units/yr	承認済 2026/5
7	CDIL	Mohali, Punjab	Discrete/SiC	1964–	61.8	550	M units/yr	稼働中
12	CDIL (Expansion)	Mohali, Punjab	Discrete/SiC Expansion	2025–	61.8	158.38	M units/yr	承認済 2025/8
13	ASIP Technologies	Andhra Pradesh	OSAT	2025–	49.3	96	M units/yr	承認済 2025/8
3	Polymatech Electronics	Oragadam, TN	Opto/Packaging	2007–	—	LED chips, opto-semiconductors	process	稼働中
—	TOTAL (excluding N/A)	—	—	—	17,798.7	—	—	—

FX: 1 USD = 95.0123 INR（2026-10-17, xe.com） | 単位: USD百万 | 出典: MeitY / PIB / India Semiconductor Mission (ISM)

先端半導体　日印連携

日印協業が始動 — Rapidus、インド2拠点に開発センター



2026年10月26日、HCLTechグローバル本社（インド・ノイダ）での調印式。
左：C Vijayakumar HCLTech CEO　右：小池淳義 Rapidus 社長CEO

2026.10.26 | 東京・インド ノイダ

RapidusとHCLTechが提携し、インドに2拠点の開発センターを開設・本格稼働。
設計機能をインド人材で補完する。

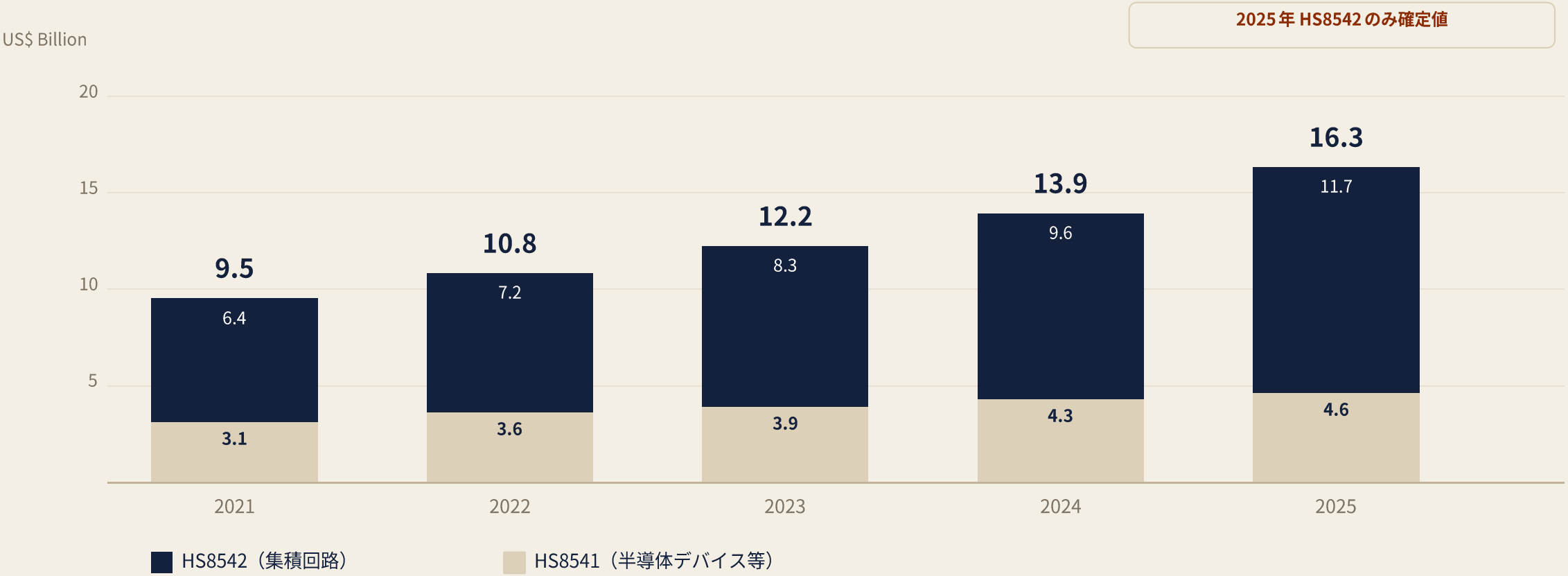
2 拠点	**開発センター（カルナタカ州ベンガルール／フブリ）** HCLTechが開設し、2026年10月26日から本格稼働。
5 領域	**設計支援の対象** マスク設計、設計インフラ、PDK開発、DTCO、レイアウト設計。
230,000 人	**HCLTechの社員数（60か国以上）** 直近12か月の連結売上高は148億ドル（2026年9月末まで）。

> 「強固なエンジニアリング・エコシステムの構築は不可欠」
> 小池淳義 代表取締役社長兼CEO

インド人材の育成 — HCLTechが現地でエンジニアを育成・確保

出典：Rapidus／HCLTech プレスリリース（2026-10-26）｜写真：同社提供

対中依存① — 半導体・電子部品の輸入額は5年で+71%

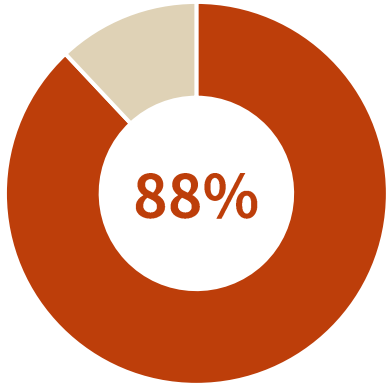


本資料の見立て — 2025年の HS8542 のみ国連統計の確定値。2021–2024年と HS8541 は推計で、算出方法は別途注記。

出典：UN Comtrade（TradingEconomics 2026年11月更新）／TrendEconomy（HS8541）／本資料推計

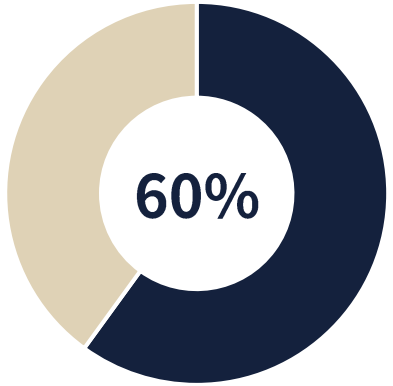
対中依存② — 半導体は中国シェア88%、電子部品全体でも約60%

HS8542　半導体
中国の輸入シェア



2025年上期／確定（GTAIC）

電子・半導体 輸入全体
中国のシェア（総額 約 US$83B）



推計（India Import Atlas）

インド IC 輸入総額
中国比率の分母

2024 年
US$21.7B
確定（OEC）

FY2025（MeitY）
US$30.3B
推計（MeitY・TradeInt）

読み方 — 半導体は中国への一極依存が続く一方、電子部品全体では国内組み立ての進展でシェアが薄まる。

区分：88% シェア・2024年 IC＝確定／60%・FY25 IC＝推計

出典：GTAIC India–China Trade Report 2017–2025／OEC／India Import Atlas／MeitY（TradeInt）

中印「半導体産業競争」— 10年後はインド優位の構図

THE CONCLUSION

10年後の世界半導体勢力図で、インドが中国を上回る存在感を示す可能性は高い

比較軸	中国 ／ CHINA	インド ／ INDIA
レガシー半導体 LEGACY	シェア16〜20%※で世界3位／28〜90nmレガシーを急伸	2028年から28〜110nm生産／急速に追い上げ、生産規模で並ぶ可能性
内需 DEMAND	スマホ／PC／EV／サーバー — 巨大だが伸びは鈍化	スマホ／サーバー／パワー — 中国を上回る伸びは確実
先端半導体 LEADING-EDGE	EUV封じ込め＋制限で7nm超に難渋／SMIC 5nm は不良率80%※	imec・IBM協力で技術移転／30年7nm・32年3nm を目標

INDIA · IN MOTION

① インドの動き

- セミコン・インディア2026 — 52カ国・600社超が出展
- マイクロン サナンドII 操業
- PSMC × タタ 前工程2028年完成
- セミコン1.0（21年）→ 2.0（26年7月）

CHINA · LIMITS

② 中国の限界

- 自給率49%目標に対し16%程度
- EUV露光装置の入手を封じ込め
- SMIC 5nm は不良率80%※

読み方 — 工業生産力・技術力では中国が上回るが、半導体はインドに有利な点が多い（原資料の結論）。

出典：月刊誌『選択』2026年10月号 WORLD欄 pp.32–33 ／ ※印はスキャンOCR由来（300dpi再読で一致確認済み）

伸び盛り — インド動画市場、スマホ視聴「まだ」5.7億人

欧米は成熟期、成長はインドへ — 配信各社が攻略に知恵を絞る巨大市場

01 市場の数字　スマホと動画は国民に根づく

SMARTPHONE USERS
5.84 億人
国内スマホ利用者数

VIDEO VIEWERS
5.72 億人
利用者の約98%

ANNUAL PLAYBACK
320 億時間
年間再生時間

2028 PROJECTION
6.57 億人
2028年の視聴者予測

02 価格と巨人　値頃感と最大手プレイヤー

NETFLIX — 月額
149 ルピー
約240円

ANIME TIMES — 初月
39 ルピー
約60円

JioStar — 有料最大手

3 億 登録会員
10 万時間 IP
6.52 億 IPL視聴

リライアンス×ウォルト・ディズニー統合。地方言語では字幕より吹き替えが優先。

03 アニメ・日本語　鍵は4言語の吹き替え

KEY — 吹き替え
ヒンディー語・タミル語など4言語
4言語の吹き替え版で事業が跳ねた

MARKET SIZE — PwC
22.77 → **34.79**
億ドル（2024年 → 2029年）／5年で約1.5倍

68% アニメ視聴比率は世界首位

インドは人口の6割以上が35歳未満 — 所得向上とネット環境の改善で視聴者は今後も増える。

出典：読売新聞 2026年10月12日（ニューデリー支局 青木佐知子）｜推計：EY・PwC・DOUクリエーションズ×GMOリサーチ、オルマックス・メディア

日本のAI等人材不足

AI・ロボット人材339万人、現場人材260万人が不足

2040年の需給 — 多くの産業で、利活用を担う人材と現場人材が不足する（単位：万人）

産業	専門職	うちAI・ロボット等の利活用を担う人材	事務職	現場人材	うち生産工程従事者	うちその他現場人材
2040年 需給ミスマッチ	−181	−339	437	−260	−206	−54
2040年 需要数／供給数	1867／1686	782／443	1039／1476	3283／3023	731／525	2552／2498
2022年 就業者数	1288	236	1455	3637	835	2803
農林水産業	−9	−7	−1	−110	−3	−107
製造業	−149	−125	−40	−256	−198	−58
情報通信業	116	102	50	13	2	11
卸売業・小売業	−81	−77	26	−20	−4	−16
建設業	−33	−26	20	−31	−2	−30
宿泊業・飲食サービス業	−21	−21	2	12	0	12
運輸業・郵便業	−25	−26	27	26	0	25

読み方：2040年に専門職は181万人不足し、そのうちAI・ロボット等の利活用を担う人材が339万人不足する（需要782万人に対し供給443万人）。一方、事務職は437万人が余る。

この需給ギャップが、日印の人材連携（高度人材の受け入れ・現地での育成）の根拠になります。

注：2022年就業者数は総務省「就業構造基本調査」・文部科学省「学校基本調査」を経済産業省が加工。表中は主な産業のみ抜粋。出典：経済産業省「2040年の就業構造推計」